



Automatic Dicing Saw DAD323

高空间效率 占地面积超小的切割机

从半导体晶圆到电子零件,多样化加工对应

最大可对应6寸之工作物

借由采用Y轴刻度规格(选配),可实现高精度之指数控制

搭配高转矩2.0kW主轴

可对应玻璃、陶瓷等难切削材料之加工。此外,亦可选择搭配高转速1.8kW主轴

(最高回转数: 60,000min⁻¹),为高泛用性之机台。

高生产效率

借采用高性能MCU提升软件运作速度及操作反应速度

X、Y、Z轴高速化,实现生产率的提升

- X轴归位速度为800mm/s (为过往之1.6倍)

	过往机型(DAD322)	DAD323
X轴	500	800
Y轴	150	200
Z轴	30	80

(mm/s)

超小的占地面积

宽490mm 实现更进一步之小巧设计

特别是将复数台装置并列运作时,对提升每单位面积之生产效率有极大贡献。

※DISCO调查



操作简易

- 自动校准机能为标准配备
- 透过15寸萤幕与GUI(Graphical User Interface) 进行操作
借由将萤幕放大可提高视认性、增加情报量
配备有与易操作的3000系列共通之操作体系 (有与DAD322之互换模式)



自动校准

◆操作画面比較

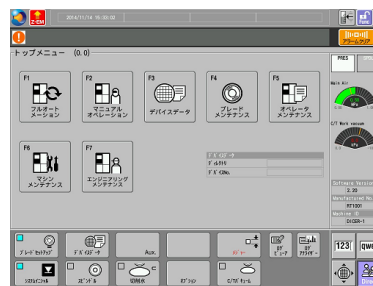


DAD322 (従来机)



DAD323

◆操作画面



3000系列



322互换模式

Specification

Specification		Unit	
Workpiece size		-	φ6" / □6" (DPR)
X-axis	Cutting range	mm	160
	Cutting speed	mm/sec	0.1 - 800
Y-axis	Cutting range	mm	162
	Index step	mm	0.0001
	Index positioning accuracy	mm	0.005/160 (Single error)0.003/5
Z-axis	Max. stroke	mm	32.2 (φ2" blades)
	Moving resolution	mm	0.00005
	Repeatability accuracy	mm	0.001
θ-axis	Max. rotating angle	deg	320
Spindle	Output	kW	2.0at40,000min ⁻¹
	Rated torque	N·m	0.48
	Revolution speed	min ⁻¹	3,000 - 40,000
Machine		mm	490 × 870 × 1,600
Machine weight		kg	Approx.400

■ 使用条件

- 请使用大气压露点在-10~-20℃，残余油分为0.1ppm，过滤度在0.01μm/99.5%以上的清洁压缩空气。
- 请将放置机械设备的房间室温设定在20℃~25℃之间，并将波动范围控制在±1℃以内。
- 请将切削水的水温控制为室温+2℃（变化波动范围在±1℃以内），将冷却水的水温控制为与室温相同（变化波动范围在±1℃以内）。
- 其它，请避免设备受到撞击及外界的有感振动。另外，请不要将设备安装在鼓风机、通风口、产生高温的装置及产生油雾的装置附近。
- 本设备会使用水。
万一发生漏水影响，请把本设备安装在有防水性之地板及有排水处理之场所。
- ※ 为了改进设备，本公司可能在未预先通知用户的情况下，就对本规格实施变更，因此请仔细确认规格后发出订单。
- ※ 压力全部使用压力表指示压力值表示。
- ※ 关于本设备的应用技术等咨询，请与本公司销售部门联络。